

次世代高密度配線技術に適応した 高解像性・高信頼性を有するソルダーレジスト

Solder Resist for next generation ultra-high density packaging technology with high resolution and reliability





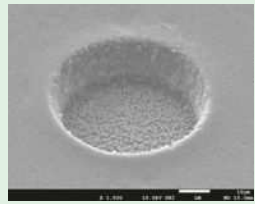
アルカリ現像型ICパッケージ基板用 ソルダーレジスト

Photo-Imageable Dry Film Solder Resist for IC Substrate
PSR-800 AUS AZ5-F/PSR-4000 AUS AZ5L

特長 Features

- **高解像性**
High Resolution
- **優れた絶縁信頼性**
High Insulation reliability
- **高クラック耐性**
Excellent Anti Crack Resistance at TST/TCT
- **ドライフィルム、液状の両方をラインナップ**
We can provide both Dry Film type and Liquid type

特性 Properties

Name	AUS AZ5-F	AUS AZ5L
Type	Dry Film	Liquid
ガラス転移点Tg *TMA method	175-185℃	175-185℃
線膨張係数 CTE (α_1)	40-45 ppm	40-45 ppm
弾性率 Young's modulus	4.0-4.5 GPa	4.0-4.5 GPa
破壊強度 Tensile strength	105-115 MPa	105-115 MPa
破壊伸び率 Elongation	7.0-7.5%	7.0-7.5%
HAST耐性 (130℃/85%RH, 3.3V, L/S=8/8)	300h Pass	300h Pass
冷熱サイクル耐性 (150℃ \leftrightarrow 60℃)	500cycle Pass	500cycle Pass
Cross section		
View angle : 45deg.		

※ Bottom Size : 35 μ m

用途 Application

- **ICパッケージ基板 FC-BGA**
IC Packaging Substrate FC-BGA

AUS SR1の後継モデル。 市場要求に応え、グロスタイプ、マットタイプ、 黒色マットタイプをラインアップ

Successor model of AUS SR1 with a lineup of
glossy type matte type and black matte type to meet market demand



アルカリ現像型ICパッケージ基板用 ドライフィルムソルダーレジスト PSR-800 AUS SR1-Z/PSR-800 AUS MG1-Z/PSR-800 AUS ME1-Z

Photo-Imageable Dry Film Solder Resist for IC Substrate

特長 Features

- **優れた解像性**
High Resolution
- **優れた絶縁信頼性**
High Insulation Reliability
- **緑色グロス／緑色マット／黒色マット仕様**
Glossy Green/Matte Green/Matte Black
- **ハロゲンフリー**
Halogen Free
- **ドライフィルムタイプ**
Dry Film Type

特性 Properties

ガラス転移点Tg *TMA method	150-160°C
線膨張係数 CTE (α_1)	40-45ppm
弾性率 Young's modulus	3.5-4.0GPa
破壊強度 Tensile strength	70-75MPa
破壊伸び率 Elongation	3.5-4.0%
HAST耐性 (130°C/85%RH, 5V, L/S=12/13)	300h Pass

Name	AUS SR1-Z	AUS MG1-Z	AUS ME1-Z
Grade	Standard grade	Matte grade	Black matte grade
Resolution ($\phi 80\mu\text{m}$)			
Surface condition ($\times 1,000$)			
Gloss level(60°)	90	23	20

用途 Application

- **IC Package基板 (メモリ、AiP、SiP、RFモジュール、等…)**
IC Packaging Substrate (For Memory, AiP, SiP, RF Module, etc...)